

臺北醫學大學一一一學年度推廣教育 醫材設計 3D 列印人才養成班招生簡章

- 一、依據：勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署產業新尖兵計畫。
- 二、目的：教導學員學習智慧醫療儀器製造的基礎圖學、電腦輔助設計軟體(如 Solidworks)，並熟悉 3D 列印技術，培養同學電腦輔助設計與 3D 列印的實務技術。
- 【結訓後可從事】**
機械設計工程師、產品設計師、醫療器材設計工程師、設計繪圖人員、機構工程師、3D 列印工程師、電腦繪圖助理、構圖工程師、模具設計工程師、個人工作室等。
- 三、班別：醫材設計 3D 列印人才養成班。
- 四、對象：**對象一：**高中職，工程相關、機械工程學類、電機電子工程相關、工業及機械相關、機械維護學類、資電理工、生命科學、醫藥衛生口腔老年照護(科)系及圖文傳播科等相關科系，對智慧醫療器材設計有興趣的民眾。
對象二：(科)系條件同上，且年滿 15~29 歲之本國籍失業青年非屬日間部在學學生，並符合產業新尖兵之補助對象。
- 五、上課期限：112 年 03 月 27 日至 112 年 05 月 11 日，每週一至五 AM 09:00~PM 16:00 (共計七週)。
- 六、收費標準：**對象一：**學費 54,692 元，報名後採用虛擬帳號方式付費，可匯款或網路銀行轉帳。
對象二：依產業新尖兵計畫規定。
- 七、上課地點：臺北醫學大學大安校區 B2 教室(B201、B202、B203、B204、B205)擇一。
(臺北市大安區基隆路 172-1 號)
- 八、報名方式：**對象一：**於官方網站【**課程網址：**<https://reurl.cc/oZ9vk5>】完成線上課程報名，取得虛擬帳號三日內付款。
對象二：產業新尖兵計畫學員請依下列步驟操作報名
1. 登錄資料：青年申請本計畫前，應登錄為「台灣就業通」會員(電子郵件將作為後續訊息發布通知重要管道，請務必確實填寫)，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗(<https://exam1.taiwanjobs.gov.tw/Interest/Index>)。
 2. 確認資格：於本計畫專區下載或列印「報名及參訓資格切結書」，閱覽切結書及相關須知，後加以簽名或蓋章，並交予訓練單位 (<https://elite.taiwanjobs.gov.tw/>)。
 3. 接著前往【**課程網址：**<https://reurl.cc/oZ9vk5>】完成線上課程報名。
- 註：1.報名後須繳交資料身份證影本，請務必於開課當天繳交於工作人員。
- 九、報名日期：報名日期:112 年 01 月 01 日至 112 年 03 月 24 日，
- 十、招生名額：25 人(最低 20 人)。
- 十一、甄選方式：甄選日期 112 年 3 月 25 日。
- (1)審查相關科系，工程相關、機械工程學類、電機電子程相關、工業及機械相關、機械維護學類、資電理工、生命科學、醫藥衛生口腔老年照護(科)系及圖文傳播科等相關科系。
 - (2)年滿 15~29 歲高中/職(含)以上之本國籍失業青年且非屬日間部在學學生，並確定是否符合產業新尖兵計畫補助對象。
 - (3)依報名先後順序電郵通知錄取。
 - (4)若有報名後向承辦人取消之名額，再依後補順序替補。
- 十二、結訓證書：本班為非學分班，修讀時數為 165 小時，不授予學位證書，僅發給結訓證書。

發給要件：
 (1)結訓前完成小組專題報告。
 (2)到課時數滿三分之二 (110 小時)。

十三退費方式： 收費對象一之學員開課後不予退費。

十五課程
 內容：

課程單元	任課教師
開訓典禮、入班宣導及班會 開訓典禮、班務管理、課程說明 小組專題討論 小組專題討論、專題製作小組討論 就業輔導演講與媒合 履歷表撰寫、面試實戰演練 廠商人資人員演講及工作媒合 課程 Q&A 總結所有學科與術科教學內容 Q/A，分組指導專題報告作品之修改 期末專題製作 學員專題報告	
基礎圖學 圖學基本概念、線條、幾何、正投影、輔助視圖、剖視圖尺度、展開圖等 工業 4.0	臺北醫學大學生物醫學 工程學系楊建中老師
物聯網技術與現代製造思維、工業產品設計及製造流程介紹 設計專題介紹 血氧機介紹、與製作流程	健行科技大學國際企業 經營系梁雲龍老師
醫療儀器相關法 醫療器材設計與開發流程管制 ISO 13485 醫療器材國際標 ISO 13485 品質系統	臺北醫學大學進修推教 育組梁燕妮
設計專題製作 血氧機製作：外觀、感測器原理、功能設計、3D 列印銑床練習、外觀功能零件、組裝電路板、組裝、功能測試、設計流程檢討。 Solidworks 軟體 3D 繪圖之畫線、刪除與修剪、旋轉、環狀、鏡射、直線、草圖、參考幾何、基準面、基準軸、共用值、數學關係式、進階結合、工程圖指令說明、線性靜態分析、掉落測試分析和疲勞分析 3D 列印 電腦輔助設計(CAD)與 3D 列印配合與運用、3D 列印技術實務及演練	

十六洽詢方式：臺北醫學大學 進修推廣處(大安校區) 臺北醫學大學 進修推廣處(校本部)
 地 址： 106 台北市大安區基隆路二段 172-1 號 13 樓 110 台北市信義區吳興街 250 號
 電 話： (02) 6638-2736 轉 1304 梁燕妮小姐 (02) 2736-1661 轉 2419
 傳 真： (02) 2738-7348 (02) 8732-1699

醫材設計 3D 列印人才養成班課程表 每週一至五 09:00~16:00 (共 7 週)

週次	日期	課程內容	時數	授課講師
第一週 6h/day 33h/week	2023/3/27(一)	開訓典禮、入班宣導及班會	3h	梁燕妮
		基礎圖學	3h	楊建中老師
	2023/3/28(二)	基礎圖學	3h	楊建中老師
		基礎圖學	3h	
	2023/3/29(三)	基礎圖學	3h	楊建中老師
		Solidworks 軟體	4h	
	2023/3/30(四)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
		小組專題討論	4h	梁燕妮
	2023/3/31	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
		Solidworks 軟體	4h	
第二週 7h/day 14h/week	2023/4/6(四)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
		小組專題討論	4h	
	2023/4/7(五)	Solidworks 軟體	3h	梁燕妮
		Solidworks 軟體	4h	楊建中老師
第三週 6h/day 22h/week	2023/4/10(一)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
		Solidworks 軟體	3h	
	2023/4/11(二)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
	2023/4/12(三)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
	2023/4/13(四)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
		小組專題討論	4h	梁燕妮
	2023/4/14(五)	Solidworks 軟體	3h	楊建中老師
第四週 6h/day 32h/week	2023/4/17(一)	3D 列印	3h	楊建中老師
		3D 列印	3h	
	2023/4/18(二)	3D 列印	3h	楊建中老師

週次	日期	課程內容	時數	授課講師
		3D 列印	3h	
	2023/4/19(三)	設計專題介紹	4h	梁雲龍老師
		設計專題介紹	2h	
	2023/4/20(四)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
		設計專題製作	4h	
	2023/4/21(五)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
設計專題製作		4h		
第五週 6h/day 24h/week	2023/4/24(一)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
		設計專題製作	4h	
	2023/4/25(二)	設計專題製作	7h	梁雲龍老師
	2023/4/26(三)	設計專題製作	4h	梁雲龍老師
	2023/4/27(四)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
	2023/4/28(五)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
第六週 6h/day 22h/week	2023/5/1(一)	設計專題製作	3h	梁雲龍老師
		設計專題製作	4h	
	2023/5/2(二)	醫療器材設計與開發流程管制	6h	梁雲龍老師
	2023/5/3(三)	醫療器材國際標準 ISO 13485 品質系統	3h	梁雲龍老師
	2023/5/4(四)	醫療器材國際標準 ISO 13485 品質系統	3h	楊建中老師
	2023/5/5(五)	工業 4.0	3h	楊建中老師
第七週 6h/day 18h/week	2023/5/8(一)	課程 Q&A	3h	楊建中老師
		期末專題製作與報告	3h	楊建中老師
	2023/5/9(二)	期末專題製作與報告	3h	楊建中老師
	2023/5/10(三)	期末專題製作與報告	3h	楊建中老師
	2023/5/11(四)	就業輔導演講與工作媒合	3h	楊建中老師
		履歷表撰寫練習優化 人員面試實戰演練	3h	楊建中老師

【楊建中】

學歷：臺北醫學大學生醫材料暨組織工程研究所 碩士

現職：

臺北醫學大學生醫光機電研究所講師

維網生物科技股份有限公司副總經理

經歷：

維網生物科技股份有限公司副總經理

專長：電腦輔助設計相關:CAD 系統整合規劃、AutoCAD 電腦輔助設計製圖、Pro/ENGINEER 產品設計、SolidWorks 產品設計、CAM 製程參數規劃、CAE 電腦輔助分析、工業設計、機械設計、機械加工法、製造程序。其他:生產管理、統計製程管制、QC 七大手法、ISO9001、ISO13485、品質管理、醫療器材設計管制及風險管理

【梁雲龍】

學歷：國立臺北科技大學機電整合研究所 碩士

現職：

健行科技大學國際企業經營系講師

富濬科技股份有限公司研發處經理

經歷：

通騰科技股份有限公司台灣技術中心技術經理

明泰科技股份有限公司設計支援處副處長

群創光電股份有限公司研發處首席設計師

專長：電腦輔助設計分析、機電整合及信號處理

【梁燕妮】

學歷：國立中正大學心理學系研究所 碩士

現職：

臺北醫學大學進修推廣處辦事員

經歷：

銘傳大學進修推廣處辦事員

中銀律師事務所人資

專長：課程、培訓企劃與執行、辦理國際型研討會、海外遊學團